

# 武汉高德红外股份有限公司

## 关于公司签订《武汉高德微机电与传感工业技术研究院共建协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1. 武汉高德红外股份有限公司（以下称“公司”）与武汉东湖新技术开发区管理委员会（以下称“开发区管委会”）、武汉市科学技术局（以下称“市科技局”）签署的《武汉高德微机电与传感工业技术研究院（以下简称“工研院”）共建协议》，为各方为搭建微机电系统应用制造平台并快速实现相关产业集群而达成的框架协议，合作中涉及的供地、投资及其他具体事项，由合作各方另行协商、签订具体协议。

2. 该协议为合作框架协议，目前尚未涉及具体事项详细实施程序，暂无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体合作事宜明确后，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，履行相应的决策和审批程序。

3. 为支持工研院建设和发展，市科技局代表武汉市人民政府在三年建设期内为工研院提供 0.5 亿元运行经费，同时开发区管委会连续 5 个合同年度对用于微机电工研院建设和发展的银行贷款给予贴息，针对上年实际发生贷款在下一年度予以全额贴息支持，每年累计贷款总额不超过 1.5 亿元，贴息利率最高不超过银行同期 5 年贷款基准利率。

4. 根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 17 号：上市公司重大合同公告格式》的规定，需要说明公司最新三年披露的框架协议，具体情况详见本公告“四、重大风险提示”之“2、近三年披露的协议相关情况”。

2018 年 5 月 28 日公司出资人民币 5,000 万元投资成立了武汉高德微机电与传感工业技术研究院有限公司，近日公司与开发区管委会、市科技局签署了《武

汉高德微机电与传感工业技术研究院共建协议》，将依托武汉东湖新技术开发区在集成电路与微机电系统领域的产业优势和人才优势，同时发挥公司在科研成果转化、大规模制造、专业管理与市场渠道等优势，共同搭建行业先进技术研发、技术产品化和企业孵化平台，快速形成微机电系统产业集群。

## 一、协议签署的基本情况

### （一）交易对方的基本情况

（1）武汉东湖新技术开发区管理委员会

（2）武汉市科学技术局

武汉东湖新技术开发区管理委员会与武汉市科学技术局均为地方政府机构。

（二）协议生效时间：2019年8月5日（以最后一方实际签署为准）

签署地点：湖北武汉

（三）协议各方之间不存在关联关系

（四）本协议书为合作框架协议，暂无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体合作事宜明确后，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，履行相应的决策和审批程序。

## 二、协议的主要内容

### （一）工研院的功能定位、性质及组织架构、建设目标、建设计划

#### 1、工研院的功能定位

构建微机电系统设计、工艺、集成的全流程研发平台，面向人工智能、自动驾驶等领域的微机电系统应用制造平台，针对微机电提供双创服务的孵化平台，促进先进科技成果转化，以微机电系统带动物联网、智慧城市发展，打造微机电系统产业集群，推动武汉市高质量发展，推动国家创新示范区的建设。

#### 2、工研院的性质及组织架构

工研院设立专家咨询委员会，由微电子、机械、光学、工程、经济等领域的院士和专家组成。工研院组建实验室或研究中心，并与武汉地区各大学、科研院所建立联合研究院、实验室。

公司设立武汉高德微机电与传感工业技术研究院有限公司，微机电工研院公司具有独立法人资格，是微机电工研院的运营实体。

#### 3、工研院的建设目标

工研院建设内容包括研发基地、产业园和泛光电产业基金（以下简称“产业基金”）。研发基地依托现有的 MEMS、复杂光电系统等设计与制造能力，建设国内一流、国际领先的微机电系统设计、测试与封装，智能新型传感器设计、制造与研发的开放性研发平台。工研院设立产业基金以推动泛光电产业在武汉东湖新技术开发区集聚，助力武汉国家创新示范区建设。

自协议签订起 3 年内，工研院完成研发基地与产业园的基础设施建设和固定资产投资，完成产业基金设立。

自协议签订起 5 年内，围绕红外探测器芯片和新型 MEMS 传感器芯片在智慧城市、智慧医疗、智能家居和智能驾驶等领域的应用展开技术研发与产业化，工研院公司自有研发团队达到 500 人，产业化团队达到 100 人；工研院公司引进 5-10 名美国工程院院士、英国皇家工程院院士级别的国际高端人才，培育 10 家智能传感器制造与应用领域技术领先企业，工研院公司及其入驻未来科技城的孵化项目授权不低于 400 项专利，带动新增年产值不低于 20 亿元，带动新增年利润 3 亿元，带动新增年税收 6,000 万元。

#### 4、工研院的建设计划

（1）工研院共建协议签订后 3 个月内，明确工研院建设实施方案，工研院正式运营。

（2）工研院共建协议签订后 4 个月内，完成工研院用地招拍挂流程，并开始启动研发基地建设。

（3）工研院共建协议签订后 3 年内，完成工研院研发基地与产业园的全部基础设施建设和固定资产投资。

#### （二）各方的职责

##### 开发区管委会职责：

1、支持工研院建设，为工研院发展提供项目用地。

2、为工研院建设和发展提供贷款贴息

（1）自协议签订之日起对应下一自然年度签订之次日为一个合同年度，连续 5 个合同年度对用于微机电工研院建设和发展的银行贷款给予贴息；

（2）针对上年实际发生贷款在下一年度予以全额贴息支持，每年累计贷款总额不超过 1.5 亿元；

（3）贴息利率最高不超过银行同期 5 年贷款基准利率。

##### 公司职责：

1、充分发挥民营企业市场化优势，建立武汉地区科研院所、企业、市场的合作协同机制，加快科技成果转化与产业孵化，把武汉打造成集成电路微机电系统设计与制造的创新高地和产业高地。

2、出资设立工研院，制定工研院建设实施方案，完成工研院建设目标。

#### 市科技局职责：

1、支持工研院建设，代表武汉市政府在建设期内为工研院提供 0.5 亿元运行经费。

2、支持工研院竞争申报武汉市科技计划项目，同等条件下予以优先支持。

#### 三、对上市公司的影响

1、预计该合作共建协议会增加 2018 年度-2020 年度的政府补助合计 5000 万元，实际到账金额以会计师事务所审计核定数据为准。

2、开发区管委会连续 5 个合同年度对用于微机电工研院建设和发展的银行贷款给予贴息，针对上年实际发生贷款在下一年度予以全额贴息支持，每年累计可贴息贷款总额不超过 1.5 亿元，贴息利率最高不超过银行同期 5 年贷款基准利率。

3、本次合作不影响公司业务独立性，公司主要业务不会因此对合作方产生重大依赖。

#### 四、重大风险提示

1、本协议为各方达成的框架协议，合作中涉及的供地、投资及其他具体事项，由合作各方另行协商、签订具体协议。请广大投资者注意投资风险。

2、近三年披露的协议相关情况

序号	重要事项概述	披露日期	披露网站查询索引
1	公司与重庆市经济和信息化委员会、中国兵器装备集团有限公司及重庆市巴南区人民政府签订了战略合作框架协议	2018 年 8 月 28 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> （详见：《2018 年半年度报告》第五节其他重要事项（十六）其他重大事项的说明中）

公司与重庆市经济和信息化委员会、中国兵器装备集团有限公司及重庆市巴南区人民政府签订了战略合作框架协议。公司通过签署该战略合作协议，拟与兵装集团、重庆市共建研究院，凭借公司在红外军民产业领域的核心技术及市场化布局优势，打造全新的、多层次的、市场导向的技术研发平台，布局基于红外夜视、智能驾驶、智能家居、手机电脑等相关红外光电研发制造项目，以拓展公司

在红外应用领域的边界、扩大公司在综合光电领域的市场地位和行业引导作用，目前与各方探讨合适的合作模式。

3、未来三个月内，公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东无减持计划。

## 五、备查文件

《武汉高德微机电与传感工业技术研究院共建协议》。

特此公告。

武汉高德红外股份有限公司

董事会

二〇一九年八月五日